

第五届 " IC创新奖 " 实施方案

一、指导思想：

通过IC创新奖的申报、评选、颁布等过程活动，鼓励创新，引导并加强产业链合作，加速创新成果产业化，营造全产业链合作发展的良好局面。

二、奖项定位：

IC创新奖重点鼓励集成电路技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现大联盟倡导全产业链合作的理念。

三、组织机构：

主办单位：中国集成电路创新联盟。

第五届IC创新奖评选活动设立提名委员会和评审委员会，分别负责提名与评审工作；大联盟秘书处负责具体组织实施工作。

秘书处联系人：

李斯琪 010-82995751, 13439052196

由春娟 010-82995892, 18210529773

邮 箱：lisiqi@ime.ac.cn

地 址：北京市朝阳区北土城西路3号

邮 编：100029

四、申报条件：

产品、技术、团队及个人奖的申报单位应在国内注册，涉及产品、技术的研发工作应主要在国内完成，具有自主知识产权。申报单位必须保证申报材料真实有效，且不存在任何违反国家相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。同款产品只能申报一个项目类别，且已获得IC创新奖的同个项目或产品不得重复申报。

五、奖项类别：

（一）技术创新奖：表彰在集成电路重大技术创新和关键技术开

发方面取得重大突破的单位和团队（不超过10项）；

（二）**成果产业化奖**：表彰在集成电路创新成果产业化推进和市场拓展方面取得突出业绩的单位和团队（不超过10项）；

（三）**产业链合作奖**：表彰在推进集成电路产业链上下游及产学研合作方面作出突出贡献的单位和团队（不超过5项）；

（四）**产业创新突出贡献奖**：表彰在集成电路技术创新、成果产业化、产业链合作及创新发展服务等方面作出突出贡献的个人（不超过5项）。

六、奖项产生及发布：

第五届IC创新奖评选程序按照奖项申请、奖项受理、奖项评选、奖项公示和奖项发布等几个步骤进行。

（一）**奖项申请**：单位申报与专家提名相结合。

1、符合条件的单位申报。申报单位按要求填写第五届“IC创新奖”申报表，由单位负责人签字并加盖单位公章（其中销售相关数据请加盖单位财务章）后，于2021年11月20日前将纸质材料原件一式一份快递至大联盟秘书处，同时将申报表电子版（命名格式：奖项类别-技术类别-申报单位-项目名称，Word版和PDF盖章扫描版）发送至秘书处联系人邮箱lisiqi@ime.ac.cn；

2、提名委员会专家提名。

（二）**奖项受理**：秘书处受理申请和提名材料，并对材料进行初审。

（三）**奖项评选**：秘书处组织评审委员会对提名项目进行评审，并于2022年2月前形成各类奖项评审结果。

（四）**奖项公示**：秘书处根据专家评审结果形成本届IC创新奖初步获奖名单，并在大联盟网站(www.ictia.cn)上进行公示，公示期（五个工作日）结束后形成本届IC创新奖最终获奖名单。

（五）**奖项发布**：第五届IC创新奖将在大联盟2022年度创新大会

上向各获奖单位、团队及个人颁发。获奖名单将同时在大联盟网站、各专业联盟网站以及行业权威媒体上公布。

七、相关介绍：

1. 中国集成电路创新联盟：是由覆盖集成电路全产业链的62家龙头企业、高校、科研院所和社会组织等于2017年3月22日在北京共同发起成立的非营利性创新组织。成员单位业务范围涵盖互联网应用、信息系统集成、电子产品整机制造、集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测、集成电路装备材料和零部件等领域。大联盟以国家战略为指引，以突破集成电路前沿技术为目标，鼓励开放式创新，促进产业链各环节的交流合作，优化产业技术创新的生态环境；探索各类资源协同的新机制，汇聚联盟内外和国内国际的创新资源和力量，推动产业技术水平的快速提升；促进电子信息领域3个国家科技重大专项成果的对接与深度融合；深入系统研究集成电路产业技术创新可持续发展战略，为“十三五”电子信息领域重大专项顺利实施及后续集成电路的协同创新提供支撑。大联盟自成立以来，围绕产业链不断完善框架体系，目前下辖集成电路设计联盟、封测联盟、装备联盟、材料联盟、零部件联盟和测试联盟等6个专业联盟，以及示范性微电子学院联盟和汽车芯片联盟等多个支撑联盟，共计成员单位600余家。

2. 提名委员会：是IC创新奖常设组织，由来自国内集成电路全产业链各领域的产业技术领军人才、战略科学家以及金融专家等组成，负责对奖项提名。

3. 评审委员会：第五届IC创新奖评审委员会由提名委员会、大联盟咨询委专家以及申报项目所属领域范围的顶级权威专家组成，负责对提名项目进行评审。

中国集成电路创新联盟

2021年10月22日